

HRDP® (High Resolution De-bondable Panel)

ガラスキャリア表面上に多層膜を形成した剥離機能付き微細回路形成用材料



剥離機能層



HRDP外観写真

特徴

- パネルサイズでの超平滑性
- 無機剥離材料を用いた高温剥離性
- スパッタ法による均一で極薄なシード層

適用例

FOPLP/FOWLPLP向け再配線層(RDL)形成に適用

